

海通证券股份有限公司

关于杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）



（上海市广东路 689 号）

二〇二二年八月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（下称“《注册办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

发行人	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司
英文名称	Hangzhou Semiconductor Wafer Co., Ltd.
法定代表人	贺贤汉
注册资本	5,032,256,776元
注册地	浙江省杭州市钱塘新区东垦路888号
注册时间	2017年9月28日
联系电话	0571-83729816
经营范围	研发、制造：高品质（功率器件、集成电路用）半导体硅片、半导体集成电路零部件、器件项目的筹建；经销自产产品并提供相关的技术咨询服务；太阳能光伏发电、售电业务；货物及技术进出口业务（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）主营业务、核心技术、研发水平

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”“中欣晶圆”）主营业务为半导体硅片的研发、生产和销售。主要产品包括 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸抛光片以及 12 英寸外延片，公司还从事半导体硅片受托加工和出售单晶硅棒业务。

公司拥有完整的半导体硅片制备工艺和全尺寸的硅片生产线，可实现从晶体生长、切片、研磨、抛光到外延的全链条生产。公司生产的半导体硅片可广泛应用于逻辑芯片、存储芯片、图像传感器、射频前端芯片、功率器件等核心领域。公司产品除满足中国大陆客户的需求外，还销往中国台湾地区、美国、日本、韩国、欧洲等多个国家或地区，拥有良好的市场知名度和影响力，并获得了境内外主流半导体企业客户的认可，与台积电、环球晶圆、客户 A、士兰微、沪硅产业、汉磊科技、合肥长鑫、长江存储、合肥晶合、绍兴中芯、青岛芯恩、华润微、华虹半导体、英诺赛科、广州粤芯、客户 B、Global Foundries、Infineon、Onsemi、Fuji Electric、Toshiba 等知名半导体企业建立了合作关系。

公司技术积累起始于控股股东上海申和于 2002 年设立的半导体硅片事业部。上海申和半导体硅片事业部主要从事 4-6 英寸半导体硅片的研发、生产和销售，并深耕半导体硅片产业 20 余年，后经业务整合，将相关资产、技术及人员纳入公司。经过多年发展，公司在掌握 6 英寸及以下半导体硅片技术的基础上，通过持续研发掌握了 8 英寸和 12 英寸半导体硅片的核心技术。

公司通过持续的研发投入，在新产品开发、生产工艺改进等方面形成了一系列科技成果，对持续提升产品品质、丰富产品布局起到了关键性的作用。

公司开发了 8 英寸和 12 英寸 COP-Free 晶体生长技术，从根本上抑制了 COP 的产生，从而为 COP-Free 硅片的生产打下了坚实的基础；开发了 12 英寸重掺砷低阻晶体生长技术及单晶炉二次加料装置技术等晶体生长核心技术，提高了晶体生长品质和效率；开发了高平坦度硅片切割技术，辅以其他技术手段和先进的生产工艺流程，保证了平坦度、翘曲度、厚度、表面金属等各项指标的稳定和优异品质；此外，公司开发、掌握了 12 英寸外延片技术，有利于缓解 12 英寸外延片主要依赖进口的局面。

公司通过完善研发创新体系、整合国内外专家优势资源，不断提升了企业的自主创新能力，相继在晶体生长工艺、硅片加工工艺和外延工艺三个方面实现了多项科技成果转化，相关成果已应用于公司 4-12 英寸抛光片、12 英寸外延片的生产和销售中。

公司取得的科技成果是公司竞争力的重要组成部分，是公司产品销售规模得以持续增长的基础。2019 年至 2021 年，公司营业收入分别为 38,654.57 万元、42,512.05 万元和 82,330.55 万元，呈持续快速增长的趋势。公司产品的规模化销售是公司科技成果与产业深度融合的具体表征。

未来，公司将根据自身发展情况，坚持市场需求与技术发展为导向，继续遵循技术创新与升级路线，加大技术创新投入，鼓励研发、推进研发项目制，丰富公司技术储备；继续完善人才发现、培养、激励机制，进一步完善激励制度激发科研人员的创新活力；加强“产学研”合作，为研发人员搭建技术创新合作与交流的平台；

持续加强研发人员的国际交流以及海外培训，培养行业内有影响力的专家型人才队伍；为继续服务客户、开拓市场，在现有产品的基础上，从纵向、横向上深挖技术创新点和潜力新品。

（三）主要经营和财务数据及指标

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	1,091,267.96	918,651.63	686,230.54	513,224.97
归属于母公司所有者权益（万元）	677,486.32	684,969.24	386,775.07	238,314.05
资产负债率（母公司）（%）	21.07	18.16	29.22	46.19
项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入（万元）	70,168.94	82,330.55	42,512.05	38,654.57
净利润（万元）	-7,998.31	-31,805.91	-42,371.21	-17,588.37
归属于发行人股东的净利润（万元）	-7,517.88	-31,661.49	-42,371.21	-17,588.37
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润（万元）	-10,535.04	-34,415.07	-45,004.75	-17,102.50
基本每股收益（元）	-0.02	-0.08	-0.17	-0.10
稀释每股收益（元）	-0.02	-0.08	-0.17	-0.10
加权平均净资产收益率（%）	-1.55	-6.31	-15.71	-7.72
经营活动产生的现金流量净额（万元）	6,706.65	-29,186.68	-19,277.12	32,010.52
现金分红（万元）	-	-	-	-
研发费用占营业收入的比例（%）	8.94	11.51	16.49	13.17

（四）发行人存在的主要风险

1、公司尚未盈利且存在继续亏损的风险

报告期内，公司的营业收入分别为38,654.57万元、42,512.05 万元、82,330.55 万元和70,168.94万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-17,102.50万元、-45,004.75万元、-34,415.07万元和-10,535.04万元，均为负值。由于公司固定资产投资较大，且8英寸、12英寸硅片生产线正式投产时间较短，部分目标客户仍处于开拓过程中，预计未来仍存在亏损的风险。

如果公司持续亏损且无法通过外部途径进行融资，将会造成公司现金流紧张，

进而对公司业务拓展、人才引进、团队稳定、研发投入、市场拓展等方面造成负面影响。

2、母公司存在累计未弥补亏损的风险

截至2022年6月30日，公司经审计的母公司报表未分配利润为-39,926.44万元，合并报表中未分配利润为-102,665.22万元，可供股东分配的利润为负值。

若公司不能尽快实现盈利，在短期内将无法完全弥补累积亏损。在首次公开发行股票并在科创板上市后，公司将存在短期内无法向股东现金分红并由新老股东共同承担累计未弥补亏损的风险，将对股东的投资收益造成不利影响。

3、客户认证风险

芯片制造企业对半导体硅片的品质有着极高的要求，对供应商的选择非常慎重。根据行业惯例，半导体硅片产品通过下游企业的认证是双方建立合作关系、实现销售的必要条件。产品认证需花费3个月至2年，甚至更长的时间，产品认证时间长短随产品用途、客户认证要求的不同而有所区别。产品认证通过后，经与客户签订订单或合同，公司可正式向客户销售符合质量要求的产品。公司的8英寸、12英寸硅片生产线正式投产时间较短，部分目标客户仍处于产品认证阶段。若公司的8英寸、12英寸硅片未能及时获得重要目标客户的认证，将对公司的经营造成不利影响。

4、固定资产投资风险

公司所处的半导体硅片行业属于典型的资本密集型行业，固定资产投资的需求较高，尤其是半导体硅片生产制造所需的晶体生长设备、抛光设备、外延设备、检测设备的关键设备的购置成本高昂，规模化生产所需的生产线建设投入巨大。截至2022年6月30日，公司固定资产账面价值为461,951.37万元、在建工程账面金额为253,275.16万元。同时，公司还在进行12英寸半导体硅片生产线项目后续投入以及丽水中欣半导体外延片项目的投入。为了保持竞争力，公司未来可能继续增加产能，将导致固定资产规模继续扩大。

此外，半导体硅片的生产线建设从设备调试、产品认证到批量生产，需要不断对制造工艺和技术参数进行调试。因此，半导体硅片的生产线从投产至达到设计产

能，需要经历较长的周期。若公司营收规模的增长无法消化大额固定资产投资带来的新增折旧，公司将面临业绩下降的风险。

5、涉及诉讼的风险

截至本招股说明书签署日，公司存在尚未了结的诉讼事项。其中，公司作为被告的诉讼事项主要包括：1、中建一局诉中欣晶圆建设工程施工合同纠纷案，该案包含土建合同及机电合同，中建一局诉讼请求公司支付工程款 36,186.99 万元及相应利息，该案尚在一审程序中。针对该诉讼事项，公司已提起反诉；2、亚翔集成诉讼中欣晶圆建设工程施工合同纠纷案，一审判决公司向亚翔集成支付工程款 10,913.08 万元及相应利息；二审裁定撤销一审判决、发回重审。目前该案尚在审理过程中。

对于上述诉讼，公司已经根据案件情况计提了预计负债，存在最终判决作出后预计负债计提金额不足、需履行额外支付义务的风险。

6、国际贸易争端加剧及半导体相关材料 and 设备进口受限的风险

2018 年以来，国际局势跌宕起伏，中国大陆面临的国际贸易环境有所恶化。2022 年，美国进一步出台了《芯片与科学法案》等政策，限制向中国大陆出口先进制程相关的半导体生产设备。公司生产所需的原材料和生产设备主要采购自境外，部分产品销往境外。如果未来中国大陆国际贸易争端进一步加剧，不排除美国及其他国家或地区进一步收紧向中国大陆出口半导体相关原材料和生产设备的限制，提高对中国大陆半导体硅片产品的进口关税，甚至限制中国大陆半导体硅片在该国家或地区的销售。如该等情形发生，将对公司的原材料采购、设备采购及产品销售造成不利影响，从而影响公司的生产经营和业务扩张。

二、发行人本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	本次公开发行股票的数量为不超过 167,741.90 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25%
发行后总股本	不超过 670,967.58 万股
定价方式	发行人和主承销商向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、

	信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价确定股票发行价格
发行方式	采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式，或证券监管部门认可的其他发行方式
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所科创板开户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
拟上市地点	上海证券交易所

三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）项目保荐代表人

本保荐机构指定李凌、张博文担任杭州中欣晶圆半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

李凌：本项目保荐代表人，投资银行总部执行董事，管理学硕士，具有15年投资银行从业经验，曾负责和参与了盛美上海（688082.SH）、华瓷股份（001216.SH）、新日股份（603787.SH）、岱美股份（603730.SH）、沪硅产业（688126.SH）、北京通美等IPO项目和云维股份（600725.SH）、宏源证券（000562.SZ）、云内动力（000903.SZ）、大东方（600327.SH）等再融资项目以及云内动力（000903.SZ）发行股份购买资产项目。

张博文：本项目保荐代表人，投资银行总部董事总经理。海通证券内训师，经济学硕士。2009年开始从事投资银行业务，主要负责或参与的项目包括：盛美上海（688082.SH）、沪硅产业（688126.SH）、德豪润达（002005.SZ）、长电科技（600584.SH）、恩华药业（002262.SZ）、山推股份（000680.SZ）、宁波精达（603088.SH）、科泰电源（300153.SZ）、金石东方（300434.SZ）、华瓷股份（001216.SZ）、中巨芯、北京通美等IPO、再融资及重大资产重组项目，具有丰富的投资银行实务经验。

（二）项目协办人

本保荐机构指定张力为本次发行的项目协办人。

张力：本项目协办人，海通证券投资银行总部副总裁，金融风险管理硕士。2017年起从事投资银行业务至今，主要参与了中芯国际、中微公司等IPO项目的发行承

销工作。

（三）项目组其他成员

本次发行项目组的其他成员：席华、王来柱、李国维、王飞、金殿龙、郭毅焘。

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

1、本保荐机构除按照交易所相关规定，将安排相关子公司参与发行人本次发行战略配售以外，本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

5、本保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐机构承诺事项

本保荐机构承诺：

一、本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

本保荐机构同意推荐发行人本次证券发行上市，具备相应的保荐工作底稿支持，并据此出具本上市保荐书。

二、本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关证

券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证上市保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、中国证监会规定的其他事项。

六、本次证券发行上市履行的决策程序

本保荐机构对发行人本次发行履行决策程序的情况进行了核查。经核查，本保荐机构认为，发行人本次发行已履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上交所规定的决策程序。具体情况如下：

1、董事会审议过程

2022年3月18日，发行人召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于本公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》《关于授权本公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券

交易所科创板上市有关事宜的议案》《关于本公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金用途的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2、股东大会审议过程

2022 年 4 月 2 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了上述与本次发行上市相关的议案。

七、保荐机构关于发行人符合科创板定位的说明

（一）发行人符合科创板行业领域要求

公司所属行业领域	√新一代信息技术	公司属于中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》之“计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39）”及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）之“计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“电子元件及电子专用材料制造”（C398），为国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》规定的鼓励类产业。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018 年版）》，公司主要产品及服务属于：1 新一代信息技术产业-1.2 电子核心产业-1.2.3 高储能和关键电子材料制造和 3.4.3.1 半导体晶体制造。
	□高端装备	
	□新材料	
	□新能源	
	□节能环保	
	□生物医药	
	□符合科创板定位的其他领域	

（二）发行人符合科创属性要求的核查情况

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例≥5%，或最近三年累计研发投入金额≥6,000 万元	√是 □否	2019 年、2020 年和 2021 年公司累计研发投入为 21,573.91 万元，占最近三年累计营业收入 163,497.17 万元的比例为 13.20%，符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（1）款的要求。
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	√是 □否	2021 年末，公司研发人员占员工总数比例为 10.99%，符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（2）款的要求。
形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）≥5 项	√是 □否	截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有已获授权的发明专利 32 项；2019 年度至 2021 年度，发行人核心技术产品收入占营业收入比例分别为 98.57%、98.16%、99.34%，公司符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（3）款的要求。

最近三年营业收入复合增长率≥20%；或最近一年营业收入金额≥3 亿元	√是 □否	2019 年、2020 年和 2021 年，公司营业收入分别为 38,654.57 万元、42,512.05 万元和 82,330.55 万元，复合增长率为 45.94%，且最近一年营业收入金额>3 亿元。公司符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（4）款的要求。
------------------------------------	-------	---

根据《科创板注册管理办法》《科创板审核规则》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》《科创属性评价指引（试行）》等有关规定，公司符合科创属性和科创板定位要求。

八、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明

本保荐机构对发行人是否符合《上市规则》规定的上市条件进行了逐项核查。经核查，本保荐机构认为发行人本次发行符合《上市规则》规定的上市条件，具体情况如下：

（一）符合中国证监会规定的发行条件

1、发行人的主体资格

发行人是依法设立且持续经营3年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。

本保荐机构调阅了发行人的工商档案、营业执照等有关资料，2017年9月15日，日本磁性控股、杭州热磁及上海申和共同签署《杭州中芯晶圆半导体股份有限公司发起人协议书》发起设立杭州中芯晶圆半导体股份有限公司（发行人曾用名）。同日，发行人召开首次股东大会（创立大会），审议通过了《杭州中芯晶圆半导体股份有限公司成立工作报告及议案》《杭州中芯晶圆半导体股份有限公司章程》等议案，并选举产生了发行人第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事。

发行人设立时的注册资本为290,000万元。2017年9月28日，发行人经杭州市市场监督管理局核准设立并取得统一社会信用代码为91330100MA2AX8UL47的《营业

执照》。2017年10月19日，发行人在杭州大江东产业集聚区行政审批局办理了外商投资企业设立备案，并取得了备案回执。

综上，发行人是依法设立、有效存续并已持续经营三年以上的股份有限公司，符合《注册管理办法》第十条的规定。

2、发行人的财务与内控

发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具无保留意见的审计报告。

发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告。

1、本保荐机构查阅了发行人相关财务管理制度，确认发行人会计核算工作规范；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，发行人财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了发行人报告期内财务状况、经营成果、现金流量。符合《注册管理办法》第十一条第一款之规定。

2、本保荐机构查阅了发行人内部控制制度，确认发行人内部控制所有重大方面是有效的。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州中欣晶圆半导体股份有限公司内部控制的鉴证报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022年6月30日在所有重大方面保持了有效的内部控制，符合《注册管理办法》第十一条第二款之规定。

3、发行人的持续经营

发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

（1）资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

本保荐机构深入了解发行人的商业模式，查阅了发行人主要合同、通过实地走访和视频等方式访谈了主要客户及供应商，与发行人高级管理人员、主要职能部门负责人和主要股东进行了访谈，了解了发行人的组织结构、业务流程和实际经营情况。确认发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，与主要股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。经核查，发行人资产完整、人员、财务、机构及业务独立，符合《注册管理办法》第十二条第一款之规定。

（2）发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近2年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

本保荐机构查阅了发行人公司章程、历次董事会、股东大会决议和记录，查阅了工商登记文件，查阅了发行人财务报告，确认发行人主营业务、管理团队和核心技术人员稳定；最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；主要股东和受主要股东支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近2年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。发行人符合《注册管理办法》第十二条第二款之规定。

（3）发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

本保荐机构查阅了发行人主要资产、核心技术、商标等的权属文件，确认发行人主要资产、核心技术、商标等权属清晰，不存在重大权属纠纷的情况。保荐机构向银行取得了发行人担保的相关信用记录文件，核查了发行人相关的诉讼和仲裁文件，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。

本保荐机构查阅分析了相关行业研究资料、行业分析报告及行业主管部门制定

的行业发展规划等，访谈了发行人高级管理人员，核查分析了发行人的经营资料、财务报告和审计报告等，确认不存在经营环境已经或者将要发生重大变化等对发行人持续经营有重大不利影响的事项。发行人符合《注册管理办法》第十二条第三款之规定。

4、发行人的规范运行

(1) 发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

本保荐机构查阅了发行人《公司章程》，查阅了所属行业相关法律法规和国家产业政策，查阅了发行人生产经营所需的各项政府许可、权利证书或批复文件等，实地查看了发行人生产经营场所，确认发行人主要经营范围为：研发、制造：高品质（功率器件、集成电路用）半导体硅片、半导体集成电路零部件、器件项目的筹建；经销自产产品并提供相关的技术咨询服务；太阳能光伏发电、售电业务；货物及技术进出口业务(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。发行人的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策。因此发行人符合《注册管理办法》第十三条第一款之规定。

(2) 最近3年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

董事、监事和高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

本保荐机构取得了发行人、控股股东关于违法违规情况的说明以及发行人无实际控制人的说明，获取了相关部门出具的证明文件，确认发行人、控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、

生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。因此发行人、控股股东符合《注册管理办法》第十三条第二款之规定。

本保荐机构查阅了中国证监会、证券交易所的公告，访谈发行人董事、监事和高级管理人员，取得了相关人员的声明文件，确认发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近 3 年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。因此，发行人符合《注册管理办法》第十三条第三款之规定。

（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元

发行人目前的股本总额为人民币 503,225.67 万元。根据发行人股东大会决议，发行人拟公开发行不超过 167,741.90 万股。本次发行后，发行人的股份总数将不超过 670,967.58 万股，发行后股本总额不低于 3,000 万元。

（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25% 以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10% 以上

发行人目前的股本总额为人民币 503,225.67 万元。根据发行人股东大会决议，发行人拟公开发行不超过 167,741.90 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。

（四）市值及财务指标符合相关规定

发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的“市值及财务指标”条件：（四）预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计意见的《审计报告》，发行人最近一年营业收入为 8.23 亿元，符合最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元的标准。

根据报告期内的增资情况以及可比公司境内上市的估值情况，发行人的预计市值不低于 30 亿元，符合所选择上市标准中的市值指标。发行人选择的具体上市标准符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条中规定的第（四）项的要求。

九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排

- 1、持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度；
- 2、有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，应督促发行人作出说明并限期纠正；情节严重的，应当向中国证监会、上海证券交易所报告；
- 3、按照中国证监会、上海证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明；
- 4、督导发行人有效执行并完善防止主要股东及其他关联方违规占用发行人资源的制度；
- 5、督导发行人有效执行并完善防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
- 6、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
- 7、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
- 8、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；
- 9、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
- 10、中国证监会规定及保荐协议约定的其他工作。

十、保荐机构和保荐代表人联系方式

保荐机构：海通证券股份有限公司

保荐代表人：李凌、张博文

联系地址：上海市广东路689号

联系电话：021-23219000

传真：021-63411627

十一、保荐机构认为应当说明的其他事项

保荐机构不存在应当说明的其他事项。

十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

本保荐机构认为，发行人符合《公司法》《证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。发行人符合科创板定位，具备在上海证券交易所科创板上市的条件。本保荐机构同意推荐杭州中欣晶圆半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市，并承担相关保荐责任。

特此推荐，请予批准！

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于杭州中欣晶圆半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名： 张 力
张 力

保荐代表人签名： 李 凌 张博文 2022年8月18日
李 凌 张博文

2022年8月18日

内核负责人签名： 张卫东
张卫东

保荐业务负责人签名： 任 澎 2022年8月18日
任 澎

保荐机构总经理签名： 李 军 2022年8月18日
李 军

2022年8月18日

保荐机构董事长、法定代表人签名： 周 杰
周 杰

2022年8月18日
保荐机构：海通证券股份有限公司
2022年8月18日